

Dell EMC PowerEdge R750xa

Technische Daten

Hinweise, Vorsichtshinweise und Warnungen

 **ANMERKUNG:** Eine ANMERKUNG macht auf wichtige Informationen aufmerksam, mit denen Sie Ihr Produkt besser einsetzen können.

 **VORSICHT:** Ein VORSICHTSHINWEIS warnt vor möglichen Beschädigungen der Hardware oder vor Datenverlust und zeigt, wie diese vermieden werden können.

 **WARNUNG:** Mit WARNUNG wird auf eine potenziell gefährliche Situation hingewiesen, die zu Sachschäden, Verletzungen oder zum Tod führen kann.

Kapitel 1: Technische Daten	4
Gehäuseabmessungen.....	5
Gehäusegewicht.....	5
Prozessor – Technische Daten.....	6
PSU – Technische Daten.....	6
Unterstützte Betriebssysteme.....	7
Kühlungslüfter – Technische Daten.....	7
Technische Daten der Systembatterie.....	8
Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser.....	8
Arbeitsspeicher – Technische Daten.....	9
Speicher-Controller – Technische Daten.....	10
Laufwerk – Technische Daten.....	10
Laufwerke.....	10
Ports und Anschlüsse - Technische Daten.....	10
Technische Daten der USB-Ports.....	10
Technische Daten des NIC-Ports.....	11
Serieller Anschluss – technische Daten.....	11
VGA-Ports – Technische Daten.....	11
IDSDM (optional).....	11
Grafik – Technische Daten.....	11
Umgebungsbedingungen.....	12
Übersicht über thermische Beschränkungen.....	13
Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische Daten.....	14

Technische Daten

Die technischen Daten und Umgebungsbedingungen für Ihr System sind in diesem Abschnitt enthalten.

Themen:

- Gehäuseabmessungen
- Gehäusegewicht
- Prozessor – Technische Daten
- PSU – Technische Daten
- Unterstützte Betriebssysteme
- Kühlungslüfter – Technische Daten
- Technische Daten der Systembatterie
- Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser
- Arbeitsspeicher – Technische Daten
- Speicher-Controller – Technische Daten
- Laufwerk – Technische Daten
- Ports und Anschlüsse - Technische Daten
- Grafik – Technische Daten
- Umgebungsbedingungen

Gehäuseabmessungen

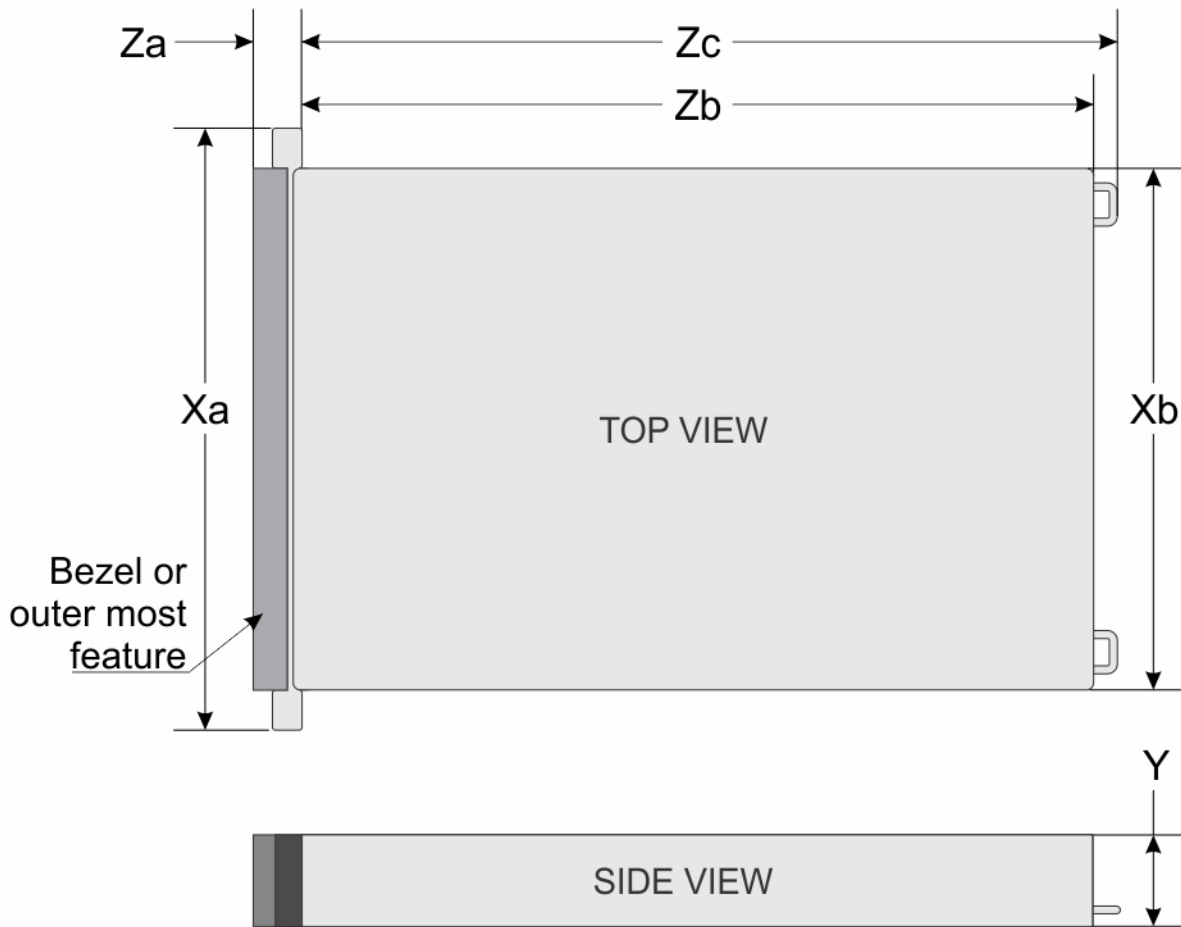


Abbildung 1. Gehäuseabmessungen

Tabelle 1. Gehäuseabmessungen für das System

Laufwerke	Xa	Xb	Y	Za	Zb	Zc
6 oder 8 Laufwerke	482,0 mm (18,97 Zoll)	434,0 mm (17,0 Zoll)	86,8 mm (3,41 Zoll)	35,84 mm (1,41 Zoll) mit Frontverkleidung 22,0 mm (0,86 Zoll) ohne Frontverkleidung	837,2 mm (32,96 Zoll) Winkel zu Rückwand	872,8 mm (34,36 Zoll) Winkel zu Netzteilgriff

ANMERKUNG: Zb ist die externe Nennfläche der Rückwand, auf der sich die E/A-Anschlüsse der Systemplatine befinden.

Gehäusegewicht

Tabelle 2. Gehäusegewicht

Systemkonfiguration	Höchstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)
6 x 2,5 Zoll + 4 x DW-FL-Karten (vorne) + 2 x LP PCIe-Karten (hinten)	29 kg (63,94 lb)

Tabelle 2. Gehäusegewicht (fortgesetzt)

Systemkonfiguration	Höchstgewicht (mit allen Laufwerken/SSDs)
8 x 2,5 Zoll + 4 x DW-FL-Karten (vorne) + 4 x PCIe-Karten (hinten)	34,9 kg (76,94 lb)

Prozessor – Technische Daten

Tabelle 3. Technische Daten des Prozessors für das Dell EMC PowerEdge R750xa

Unterstützter Prozessor	Anzahl der unterstützten Prozessoren
Intel Xeon Scalable-Prozessoren der 3. Generation mit bis zu 40 Kernen	zwei

PSU – Technische Daten

Das System unterstützt bis zu zwei Wechselstrom- oder Gleichstrom-Netzteile (PSUs).

⚠️ WARNUNG: Anweisungen nur für ausgebildete Elektriker:

Systeme, in denen Gleichstromnetzteile mit -(48–60) VDC oder 240 VDC verwendet werden, sind gemäß den Artikeln 110-5, 110-6, 110-11, 110-14 und 110-17 des National Electrical Code, American National Standards Institute (ANSI)/ National Fire Protection Association (NFPA) 70 für Orte mit eingeschränktem Zugang vorgesehen.

Gleichstromnetzteile mit 240 VDC müssen an den Ausgang für 240 VDC einer zertifizierten Stromverteilungseinheit angeschlossen werden, falls im Verwendungsland oder der Verwendungsregion vorgeschrieben.

Stromversorgungskabel oder Jumper-Kabel und die zugehörigen Stecker/Einlässe/Anschlüsse müssen über entsprechende elektrische Nennwerte verfügen, die sich auf das Typenschild auf dem System beziehen, wenn sie zur Verbindung verwendet werden.

Tabelle 4. Technische Daten der PSUs für das System

Netzteil	Klasse	Wärmeabgabe (maximal)	Frequenz (Speichertaktrate)	Spannung	Spitzenstrom	k. A.	k. A.	Spitzenstrom	k. A.	Strom
					Highline/-72 VDC	Highline/-72 VDC	Highline 240 VDC	Lowline/-40 VDC	Lowline/-40 VDC	
1400 W Wechselstrom (AC)	Platin	5.459 BTU/h	50/60 Hz	100–240 V	2380 W	1400 W	1400 W	1785 W	1050 W	12–8 A
1400 W Gemischter Modus HVDC (nur für China)	k. A.	5.459 BTU/h	k. A.	240 V	2380 W	1400 W	1400 W	1785 W	1050 W	6,6 A
2400 W Wechselstrom (AC)	Platin	9213 BTU/h	50/60 Hz	100–240 V	4080 W	2400 W	2400 W	2380 W	1400 W	16–13,5 A
2400 W Gemischter Modus HVDC	k. A.	9213 BTU/h	k. A.	240 V	2380 W	1400 W	1400 W	1785 W	1050 W	11,2 A

Tabelle 4. Technische Daten der PSUs für das System (fortgesetzt)

Netzteil	Klasse	Wärmeabgabe (maximal)	Frequenz (Speichertakte)	Spannung	Spitzenstrom	k. A.	k. A.	Spitzenstrom	k. A.	Strom
					Highline/-72 VDC	Highline/-72 VDC	Highline 240 VDC	Lowline/-40 VDC	Lowline/-40 VDC	
(nur für China)										

ANMERKUNG: Verwenden Sie beim Auswählen und Aufrüsten der Systemkonfiguration den Dell Energy Smart Solution Advisor unter Dell.com/ESSA, um den Stromverbrauch des Systems zu prüfen und eine optimale Energienutzung zu gewährleisten.

Unterstützte Betriebssysteme

Das PowerEdge R750xa-System unterstützt die folgenden Betriebssysteme:

- Canonical Ubuntu Server LTS
- Citrix Hypervisor
- Microsoft Windows Server mit Hyper-V
- Red Hat Enterprise Linux
- SUSE Linux Enterprise Server
- VMware ESXi

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dell.com/ossupport.

Kühlungslüfter – Technische Daten

Kühlungsoptionen

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System erfordert verschiedene Kühlungskomponenten, die auf Prozessor-TDP, Speichermodulen, grafischer Verarbeitungseinheit (GPU) und persistentem Speicher basieren, um eine optimale thermische Leistung sicherzustellen.


Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System bietet zwei Arten von Kühlungsoptionen:

- Luftkühlung
- Prozessor-Flüssigkeitskühlung (optional)

Kühlungslüfter – Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt bis zu sechs Kühlungs­lüfter.

Tabelle 5. Kühlungslüfter – Technische Daten

Lüftertyp	Abkürzung	Auch bekannt als	Kennzeichnungsfarbe	Beschriftungsbild
Systemlüfter	Lüfter	Systemlüfter (60 x 76 mm)	-	 <p>Abbildung 2. Systemlüfter (60 x 76 mm)</p>

Technische Daten der Systematterie

Das PowerEdge R750xa-System unterstützt als Systematterie eine CR 2032; 3,0-V-Lithium-Knopfzellenatterie.

Technische Daten der Erweiterungskarten-Riser

Das Dell EMC PowerEdgeR750xa-System unterstützt bis zu vier Riser-Steckplätze mit voller Bauhöhe oder acht Riser-Steckplätze mit flachen Profilen mit PCI Express (PCIe) Gen 4-Erweiterungskarten.

Tabelle 6. Auf der Systemplatine unterstützte Erweiterungskartensteckplätze

PCIe-Steckplatz	Mit GPGPU-Abdeckung	GPU-Riser-Modul rechts mit R1 Paddle-Karte	R2a (Riser 2)	R3b (Riser 3)	GPU-Riser-Modul links mit R4 Paddle-Karte
Steckplatz 3	Low-Profil – Halbe Baulänge	-	x16	-	-
Steckplatz 4	Volle Bauhöhe – Halbe Baulänge	-	-	x8	-
Steckplatz 5	Volle Bauhöhe – Halbe Baulänge	-	-	x8	-
Steckplatz 6	Low-Profil – Halbe Baulänge	-	x16	-	-
Steckplatz 31	Einfache Breite/ doppelte Breite – Volle Bauhöhe – Volle Baulänge (mit kundenspezifischer Dell Halterung)	-	-	-	x16

Tabelle 6. Auf der Systemplatine unterstützte Erweiterungskartensteckplätze (fortgesetzt)

PCIe-Steckplatz	Mit GPGPU-Abdeckung	GPU-Riser-Modul rechts mit R1 Paddle-Karte	R2a (Riser 2)	R3b (Riser 3)	GPU-Riser-Modul links mit R4 Paddle-Karte
Steckplatz 32	Einfache Breite/ doppelte Breite – Volle Bauhöhe – Volle Baulänge (mit kundenspezifischer Dell Halterung)	-	-	-	x16
Steckplatz 33	Einfache Breite/ doppelte Breite – Volle Bauhöhe – Volle Baulänge (mit kundenspezifischer Dell Halterung)	x16	-	-	-
Steckplatz 34	Einfache Breite/ doppelte Breite – Volle Bauhöhe – Volle Baulänge (mit kundenspezifischer Dell Halterung)	x16	-	-	-

Arbeitsspeicher – Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt die folgenden Speicherspezifikationen für den optimalen Betrieb:

Tabelle 7. Arbeitsspeicher – Technische Daten

DIMM-Typ	DIMM-Rank	DIMM-Kapazität	Einzelprozessor		Zwei Prozessoren	
			RAM (Minimum)	RAM (Maximum)	RAM (Minimum)	RAM (Maximum)
RDIMM	Single-Rank	8 GB	8 GB	128 GB	16 GB	256 GB
	Zweifach	16 GB	16 GB	256 GB	32 GB	512 GB
		32 GB	32 GB	512 GB	64 GB	1 TB
		64 GB	64 GB	1 TB	128 GB	2 TB
LRDIMM	Quad-Rank	128 GB	128 GB	2 TB	256 GB	4 TB
Persistenter Intel Speicher der Serie 200 – BPS	Zweifach	128 GB	128 GB	1 TB	256 GB	2 TB
		256 GB	256 GB	2 TB	512 GB	4 TB
		512 GB	512 GB	4 TB	1 TB	8 TB

ANMERKUNG: 8 GB RDIMM wird vom Persistenter Intel Speicher der Serie 200 – BPS nicht unterstützt.

Tabelle 8. Speichermodulsocket

Speichermodulsocket	Geschwindigkeit
32, 288 Stifte	3200 MT/s

Speicher-Controller – Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt die folgenden Controllerkarten:

Tabelle 9. Speicher-Controller-Karten für das System

Interne Controller	Externe Controller
<ul style="list-style-type: none"> • S150 • PERC H745 • PERC H755 • PERC H755N • PERC H345 • PERC H355 • HBA355I • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S2): HWRAID 2 x M.2 SSDs 240 GB oder 480 GB • Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-S1): HWRAID 2 x M.2-SSDs mit 240 GB, 480 GB 	<ul style="list-style-type: none"> • PERC H840 • HBA355E

ANMERKUNG: Das SoftwareRAID S150 wird auf beiden SATA-Laufwerken mit Chipsatz SATA nur mit Rückwandplatine oder NVMe-Laufwerken in universellen Steckplätzen mit PCIe Prozessorkabel verbundener Rückwandplatine unterstützt.

Laufwerk – Technische Daten

Laufwerke

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt:

- 8 x Hot-Swap-fähige 2,5-Zoll-SAS-, -SATA- oder -NVMe-Laufwerke.
- 6 x 2,5 Zoll Hot-Swap-fähige NVMe-Laufwerke.

ANMERKUNG: Weitere Informationen zum Hot-Swap-Verfahren für NVMe-PCIe-SSD-U.2-Geräte finden Sie im *Benutzerhandbuch für Dell Express Flash NVMe-PCIe-SSDs* unter <https://www.dell.com/support> **Alle Produkte durchsuchen** > **Rechenzentrumsinfrastruktur** > **Speicheradapter und Controller** > **Dell PowerEdge Express Flash-NVMe-PCIe-SSD** > **Dokumentation** > **Handbücher und Dokumente**.

Ports und Anschlüsse - Technische Daten

Technische Daten der USB-Ports

Tabelle 10. USB – Technische Daten

Vorderseite		Rückseite		Intern (optional)	
USB-Porttyp	Anzahl von Ports	USB-Porttyp	Anzahl von Ports	USB-Porttyp	Anzahl von Ports
USB 2.0-konformer Port	Eins	USB 2.0-konformer Port	Eins	Interner USB 3.0-konformer Anschluss	Eins
Micro-USB 2.0, iDRAC Direct	Eins	USB 3.0-konforme Anschlüsse	Eins		

ANMERKUNG: Der Micro-USB 2.0-konforme Anschluss kann nur als iDRAC Direct- oder Verwaltungsanschluss verwendet werden.

ANMERKUNG: Die USB 2.0-Spezifikationen sehen eine 5-V-Versorgung über eine einzige Leitung zur Versorgung angeschlossener USB-Geräte vor. Eine Einheitslast ist definiert als 100 mA bei USB 2.0 und 150 mA bei USB 3.0. Ein Gerät darf maximal 5 Einheitslasten (500 mA) von einem Anschluss in USB 2.0; 6 (900 mA) in USB 3.0 ziehen.

ANMERKUNG: Die USB 2.0-Schnittstelle kann Peripheriegeräte mit geringem Stromverbrauch mit Strom versorgen, muss aber der USB-Spezifikation entsprechen. Für den Betrieb von Peripheriegeräten mit höherer Leistung, wie z.B. externen CD/DVD-Laufwerken, ist eine externe Stromquelle erforderlich.

Technische Daten des NIC-Ports

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt bis zu zwei NIC-Ports (Network Interface Controller), die auf dem LAN on Motherboard (LOM) und in den optionalen OCP-Karten integriert sind.

Tabelle 11. Technische Daten der NIC-Ports für das System

Funktion	Technische Daten
LOM-Karte	1 GbE x 2
OCP-Karte (OCP 3.0)	1 GbE x 4, 10 GbE x 2, 10 GbE x 4, 25 GbE x 2, 25 GbE x 4

Serieller Anschluss – technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa System unterstützt ein optionaler serieller Anschluss (Kartentyp). Hierbei handelt es sich um einen 9-poliger Anschluss, Data Terminal Equipment (DTE), 16550-konform .

Die optionale serielle Anschlusskarte wird ähnlich eines Erweiterungskarten-Abdeckblechs installiert.

VGA-Ports – Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt jeweils Eins DB-15-VGA-Port auf der Vorder- und Rückseite (optional für Flüssigkeitskühlung).

IDSDM (optional)

Das Dell EMC PowerEdge R750xa System unterstützt das interne Dual SD-Modul (IDSDM).

Das IDSDM unterstützt zwei SD-Karten und ist in den folgenden Konfigurationen verfügbar:

Tabelle 12. Unterstützte SD-Kartenspeicherkapazität

IDSDM-Karte
<ul style="list-style-type: none">• 16 GB• 32 GB• 64 GB

ANMERKUNG: Ein IDSDM-Kartensteckplatz ist für die Redundanz reserviert.

ANMERKUNG: Verwenden Sie SD-Karten der Marke Dell EMC, die den IDSDM-konfigurierten Systemen entsprechen.

Grafik – Technische Daten

Das Dell EMC PowerEdge R750xa-System unterstützt einen integrierten Matrox G200-Grafikcontroller mit 16 MB Videoframebuffer.

Tabelle 13. Unterstützte Auflösungsoptionen für das System

Auflösung	Bildwiederholfrequenz (Hz)	Farbtiefe (Bit)
1024 X 768	60	8, 16, 32
1280 x 800	60	8, 16, 32
1280 X 1024	60	8, 16, 32
1360 x 768	60	8, 16, 32
1440 X 900	60	8, 16, 32
1.600 x 900	60	8, 16, 32
1.600 x 1.200	60	8, 16, 32
1.680 x 1.050	60	8, 16, 32
1.920 x 1.080	60	8, 16, 32
1920 x 1200	60	8, 16, 32

Umgebungsbedingungen

i ANMERKUNG: Weitere Informationen zu Umweltzertifizierungen finden Sie in den *Datenblättern zu Produkt und Umwelt* in den Handbüchern und Dokumenten auf www.dell.com/support/home.

Tabelle 14. Betriebsklimabereich Kategorie A2

Temperatur	Technische Daten
Zulässige kontinuierliche Vorgänge	
Temperaturbereiche für Höhen < 900 m (< 2953 ft)	10–35 °C (50–95 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
Prozentbereiche für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit nicht kondensierend)	8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit mit 21 °C (69.8 °F) Maximaltaupunkt
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung	Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 300 m (33,8°F / 984 ft) oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 15. Betriebsklimabereich Kategorie A3

Temperatur	Technische Daten
Zulässige kontinuierliche Vorgänge	
Temperaturbereiche für Höhen < 900 m (< 2953 ft)	5-40 °C (41-104 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
Prozentbereiche für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit nicht kondensierend)	8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 85% relative Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung	Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 175 m (33,8°F / 574 ft) oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 16. Betriebsklimabereich Kategorie A4

Temperatur	Technische Daten
Zulässige kontinuierliche Vorgänge	
Temperaturbereiche für Höhen < 900 m (< 2953 ft)	5-45 °C (41-113 °F) ohne direkte Sonneneinstrahlung auf die Geräte
Prozentbereiche für Luftfeuchtigkeit (zu jeder Zeit nicht kondensierend)	8 % relative Luftfeuchtigkeit mit -12 °C Mindesttaupunkt bis 90% relative Luftfeuchtigkeit mit 24°C (75.2 °F) Maximaltaupunkt
Betriebshöhe – Leistungsreduzierung	Die maximale Temperatur verringert sich um 1 °C / 125 m (33,8°F / 410 ft) oberhalb von 900 m (2953 ft).

Tabelle 17. Gemeinsame Anforderungen in allen Kategorien

Temperatur	Technische Daten
Zulässige kontinuierliche Vorgänge	
Maximaler Temperaturanstieg (gilt für Betrieb und Nichtbetrieb)	20 °C in einer Stunde* (36 °F in einer Stunde) und 5 °C in 15 Minuten (9 °F in 15 Minuten), 5 °C in einer Stunde* (9 °F in einer Stunde) für Bandhardware <i>i</i> ANMERKUNG: *: Bei den thermischen Richtlinien von ASHRAE für Bandlaufwerke handelt es sich nicht um unverzügliche Temperaturschwankungen.
Temperaturgrenzwerte bei Nichtbetrieb	-40 bis 65 °C (-104 bis 149 °F)
Luftfeuchtigkeitsgrenzwerte bei Nichtbetrieb	5 % bis 95 % relative Luftfeuchtigkeit bei einem Maximaltaupunkt von 27 °C (80.6 °F)
Maximale Höhe außerhalb des Betriebs	12.000 m (39.370 Fuß)
Maximale Höhe über NN bei Betrieb	3.048 m (10.000 Fuß)

Tabelle 18. Zulässige Erschütterung – Technische Daten

Zulässige Erschütterung	Technische Daten
Während des Betriebs	0,21 G _{rms} bei 5 Hz bis 500 Hz über 10 Minuten (alle Betriebsrichtungen)
Speicher	1,88 G bei 10 Hz bis 500 Hz über 15 Minuten (alle sechs Seiten getestet)

Tabelle 19. Technische Daten für maximal zulässige Stoßwirkung

Maximal zulässige Stoßeinwirkung	Technische Daten
Während des Betriebs	Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 6 G von bis zu 11 ms Dauer in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung.
Speicher	Sechs nacheinander ausgeführte Stöße mit 71 G von bis zu 2 ms Dauer in positiver und negativer X-, Y- und Z-Richtung (ein Stoß auf jeder Seite des Systems)

Übersicht über thermische Beschränkungen

Tabelle 20. Etikettreferenz

Kennzeichnung	Beschreibung
STD	Standard
HPR	Hohe Leistung
HSK	Kühlkörper
LP	Low-Profile
FH	Volle Bauhöhe
DW	Doppelte Breite (Xilinx FPGA-Beschleuniger)
BPS	Persistenter Intel Speicher der Serie 200 – BPS

Tabelle 21. Prozessor- und Kühlkörpermatrix

Kühlkörper	Prozessor-TDP
2HE HPR HSK	Für alle Prozessor-TDP

Tabelle 22. Übersicht über thermische Beschränkungen

Konfiguration		Minimum	Standard	Maximal	Umgebungstemperatur
Front GPU TDP		70 W SW x 4	250 W DW x 4	300 W DW x 4	
Vordere Laufwerke		1 x SAS/SATA	8 x SAS/SATA	8 x NVMe	
CPU-TDP/ cTDP	105 W	Systemlüfter (60 x 76 mm) mit 2HE-HPR-HSK			35 °C
	120 W				
	135 W				
	150 W				
	165 W				
	185 W				
	205 W				
	220 W				
	230 W				
	240 W				
	250 W				
	265 W				
	270 W				

- ANMERKUNG:** Für alle Konfigurationen sind sechs Systemlüfter (60 x 76 mm) erforderlich.
- ANMERKUNG:** Die T4-GPU-Karte wird auf dem Riser 2 (R2a-Steckplatz 3/6) mit maximaler Strombelastung unterstützt.
- ANMERKUNG:** Xeon (R) 8368Q unterstützt nur die Flüssigkeitskühlung des Prozessors.
- ANMERKUNG:** Es wird nur die Umgebungstemperatur der Kategorie ASHRAE A2 unterstützt.
- ANMERKUNG:** Für alle Speicherkonfigurationen wird nur der Systemlüfter (60 x 76 mm) mit 2HE-HPR-HSK verwendet.
- ANMERKUNG:** BPS DIMMs werden nur bei einer Umgebungstemperatur von 30 °C unterstützt.
- ANMERKUNG:** 128 GB LRDIMM, 64 GB RDIMM, 32 GB RDIMM, 16 GB RDIMM und 8 GB RDIMM, unterstützt bei einer Umgebungstemperatur von 35 °C.

Partikel- und gasförmige Verschmutzung - Technische Daten

Die nachfolgende Tabelle definiert die Beschränkungen, mit deren Hilfe etwaige Schäden im System und Versagen durch partikel- und gasförmige Verschmutzung vermieden werden können. Wenn die partikel- oder gasförmige Verschmutzung die spezifischen Werte der Beschränkungen überschreitet und es zur Beschädigung oder einem Versagen des Systems kommt, müssen Sie die Umgebungsbedingungen möglicherweise korrigieren. Die Korrektur von Umgebungsbedingungen liegt in der Verantwortung des Kunden.

Tabelle 23. Partikelverschmutzung – Technische Daten

Partikelverschmutzung	Technische Daten
Luftfilterung	Rechenzentrum-Luftfilterung gemäß ISO Klasse 8 pro ISO 14644-1 mit einer oberen Konfidenzgrenze von 95 %. ANMERKUNG: Die Bedingungen gemäß ISO Klasse 8 Zustand gelten ausschließlich für Rechenzentrumsumgebungen. Diese Luftfilterungsanforderungen beziehen sich nicht auf IT-Geräte, die für die Verwendung außerhalb eines Rechenzentrums, z. B. in einem Büro oder in einer Werkhalle, konzipiert sind.

Tabelle 23. Partikelverschmutzung – Technische Daten (fortgesetzt)

Partikelverschmutzung	Technische Daten
	<p>i ANMERKUNG: Die ins Rechenzentrum eintretende Luft muss über MERV11- oder MERV13-Filterung verfügen.</p>
Leitfähiger Staub	<p>Luft muss frei von leitfähigem Staub, Zinknadeln oder anderen leitfähigen Partikeln sein.</p> <p>i ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.</p>
Korrosiver Staub	<ul style="list-style-type: none"> • Luft muss frei von korrosivem Staub sein • Der in der Luft vorhandene Reststaub muss über einen Deliqueszenzpunkt von weniger als 60 % relativer Feuchtigkeit verfügen. <p>i ANMERKUNG: Diese Bedingung bezieht sich auf Rechenzentrums- sowie Nicht-Rechenzentrums-Umgebungen.</p>

Tabelle 24. Gasförmige Verschmutzung – Technische Daten

Gasförmige Verschmutzung	Technische Daten
Kupfer-Kupon-Korrosionsrate	<300 Å/Monat pro Klasse G1 gemäß ANSI/ISA71.04-2013.
Silber-Kupon-Korrosionsrate	<200 Å/Monat gemäß ANSI/ISA71.04-2013.